



(Taiwan)

Heterogeneous Integration and Advanced Packaging Technology are Accelerating, EVG will Reveal the Development Trend of Hybrid Bonding and Inspection – August 30, 2023



異質整合與先進封裝技術加快，EVG將揭露混合接合與檢測發展趨勢(13:15)

日期：2023/8/30

分享   

列印      

【財訊快報 / 記者李純君報導】AI、HPC等趨勢驅動先進封裝、異質整合等技術的加速發展，並成為半導體產業現下主要的幾項技術發展主軸，為此，微機電系統（MEMS）、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備廠商EVG Group（EVG），今日宣布，將在下週的SEMICON Taiwan 2023中，揭露3D/異質整合及擴增實境（AR）波導管製造的全新發展。

晶圓接合、微影與檢測解決方案，促成了先進封裝（包括背照式CMOS影像感測器與其它3D-IC堆疊裝置）、微機電系統與化合物半導體等領域中技術創新的開發與量產。

EVG將揭露針對異質整合在混合接合與檢測的解決方案，以及超穎光學及擴增實境波導管製造的奈米壓印微影解決方案，也提到，這些進展是由該公司先進之晶圓到晶圓（W2W）與晶粒到晶圓（D2W）混合接合、檢測與奈米壓印微影（NIL）解決方案所促成。

而在本次半導體展中，EVG業務發展總監Thomas Uhrmann，將針對奈米壓印微影的多功能性與近期成就提出概述，並聚焦在超穎透鏡與AR波導管的製造，以及該技術能力正如何快速崛起中。此外，在異質整合全球高峰會中，更會針對晶圓到晶圓與晶粒到晶圓混合接合的當前產業趨勢與技術進展提出概述，下一個技術轉型將導入通用的高密度互連技術，從而導致一個新的整合過程。整合流程的選擇將視互連密度、晶片大小、系統良率與成本等因素而定。

此外，EVG台灣資深應用暨技術部工程師Jason Li，也會針對各種應用當前的疊層檢測需求提出概述，包括晶粒到晶圓、晶圓到晶圓以及新型封裝方法的晶粒偏移，如搭載自適應圖案的無光罩微影。瞭解並應對這些檢測需求，對於推進3D與異質整合技術及達成高效率且可靠的製造良率有其重要性。

再者，EVG技術執行總監Paul Lindner，也會針對次世代記憶體與邏輯裝置相關的當前產業趨勢提出概述，並聚焦在3D整合如何推動全新的技術進步。其中包括結合熔融接合與混合接合的討論，以及超薄薄膜的分離技術，而該技術代表先進半導體裝置的全新微影微縮。

<http://www.investor.com.tw/onlinenews/NewsContent.asp?articleNo=14202308300090>